INVESTOR RELATIONS 2025

# CMTX

## THE WORLD'S BEST SEMICONDUCTOR COMPANY

CMTX
The World's Best Semiconductor Company

# DISCLAIMER

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 씨엠티엑스(이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는
법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

Investor Relations 2025

# TABLE OF CONTENTS

## Prologue


01. 에칭(식각) 공정의 중요성
02. Si Parts 선호 Trend
03. CMTX 밸류체인 소개
04. CI

Chapter 01

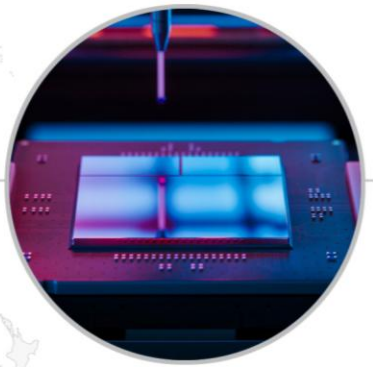
## 회사소개


01. 회사개요
02. 회사 연혁
03. 사업영역
04. 생산 인프라
05. Si Parts 제조 공정도
06. 경영성과(연결)

Chapter 02

## Core Competitiveness


01. 소재 내재화 역량
02. CMTX의 차별화 역량
03. 반도체 Parts 기술 선도 (1) S사
03. 반도체 Parts 기술 선도 (2) TSMC
04. 진입장벽 구축
05. 글로벌 고객 레퍼런스
06. 글로벌 수출액 현황
07. 수익성 지표 비교

Chapter 03

## Growth Strategy


01. 글로벌 Si 파츠 시장규모 및 전망
02. 반도체 제조사 최근 동향 (1) 원가 절감
02. 반도체 제조사 최근 동향 (2) 기술적 자립
03. 주력 제품 매출 확대
04. 소재 Recycling 사업
05. 신기술 개발
06. 매출 Forecast
07. 투자 하이라이트

## Appendix


01. IPO Plan
02. 요약 재무제표(연결)

INVESTOR RELATIONS 2025

# Prologue

01. 에칭(식각) 공정의 중요성
02. Si Parts 선호 Trend
03. CMTX 밸류체인 소개
04. CI

01 Investor Relations 2025

# 에칭(식각)공정의 중요성

## 반도체 제조사의 수익성과 경쟁력을 좌우하는 원가·수율 관리 핵심 공정

### 에칭(식각) 공정의 특징

선단공정, 미세화·고단화 심화

- 플라즈마 강도 ↑ : 극한의 공정 환경 노출
- 파티클 발생 가능성 ↑ : 수율 저하 근본적 원인
- 식각 소모품 교체 주기 단축 : 유지보수 비용 증가 → 제조원가 상승

**1. 원가 관리 측면**

**반도체 제조 공정 비용의 40~80%를 차지하는 핵심 단계**

- 극한의 환경에서 장비·소모품 투입이 가장 큰 영역
- 효율화 수준의 여부가 제조 마진을 가르는 핵심 과정
- 제조사의 수익성과 직결되는 필수 단계

**2. 수율 관리 측면**

**반도체 제조 공정에서 생산 수율 결정**

- 파티클 발생 시 전체 칩 불량으로 직결되는 고위험 단계
- 불량 발생 시 후공정에서 보정 불가능한 특수 영역
- 공정 수율 편차 관리가 곧 제조 경쟁력으로 연결되는 핵심 요인

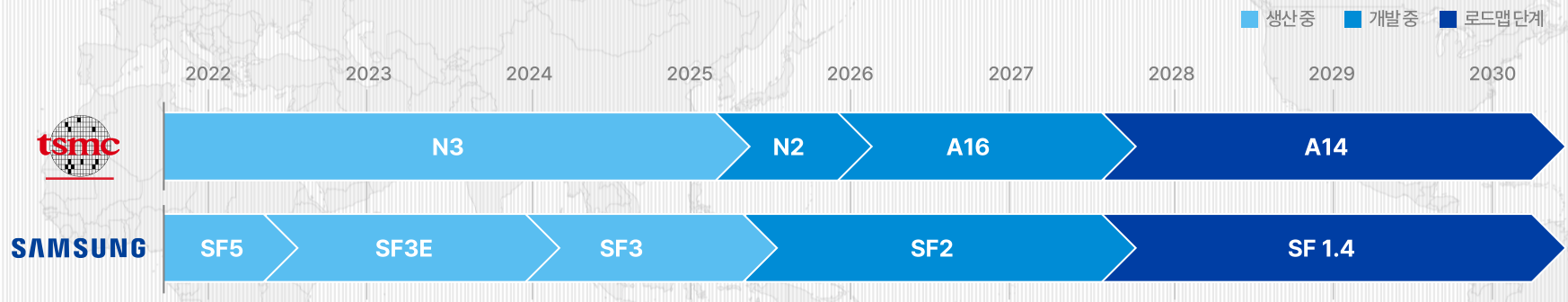
**선단공정으로 갈수록 집중적인 원가절감 및 수율 관리가 필요한 주요 핵심 공정**

02 Investor Relations 2025

# Si Parts 선호 Trend

## 초미세 공정의 진전과 함께 수율 확보를 위한 고순도 Si Parts 수요 확대

### 글로벌 파운드리 기술 로드맵




자료 : 각 사 발표, 다수 언론 보도 인용(한국무역협회,뉴시스 등)

| 구분 | CVD-SiC Parts | 고순도 Si Parts |
|---|---|---|
| 파티클 안정성 | Polymer 탈착 이슈 가능 | 최근 비약적 향상 |
| 내식성 | 모든 플라즈마에 강함 | F계 충분히 강함 |
| 가공성 (커스터마이징) | 제한적 | 매우 우수 |
| 비용 / 납기 | 고비용 / 리드타임 김 | 저비용 / 빠름 |
| 적용 공정 | 고강도 컨덕터/메탈 에칭 | 옥사이드, 일부 컨덕터 |
| 장비 플랫폼 기술 | 매우 불리함 | 유리 |

**Si Parts 특징**

**고순도 & 저오염성**

웨이퍼와 동일 소재로 제조되어 금속성 오염 최소화
→ 수율(Yield)확보 핵심 역할

**비용 효율성**

SIC Parts 대비 2배 이상 저렴한 가격 경쟁력
→ 생산 원가 절감 및 장기적 비용 효율성 강화

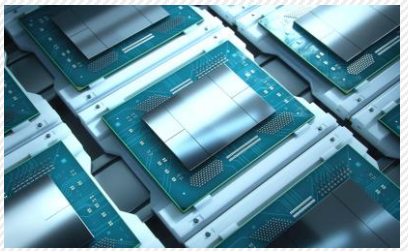
**고수율 확보를 위해 웨이퍼와 동일 물성(Si)의 고순도 부품 선호 증가**

03 Investor Relations 2025

# CMTX 밸류체인 소개

## 소재 공급 안정성과 원가 절감을 동시에 실현하는 밸류체인 구축

### 에칭(식각) 소모품 밸류체인

| 소재 생산 | Si 부품 제조사 | 장비 제조사 | 반도체 제조사 |
|---|---|---|---|
| | | |  |
| 자회사인 (주)셀릭 등<br>실리콘 잉곳 생산 기업 | CMTX 등 반도체 부품 제조사 | TEL, Lam, SEMES 등 장비사 | 삼성전자, TSMC 등 반도체 제조사 |

### 밸류체인 내 납품 구조 비교

| | 소재 생산 | Si 부품 제조 | 납품 구조 |
|---|---|---|---|
| Before market[1] 사 | ○ | ○ | → 장비 제조사 → 반도체 제조사 |
| After market[2] 사 | | ○ | → 반도체 제조사 |
| **CMTX** | ○ | ○ | → 반도체 제조사 |

**CMTX의 "소재 생산 역량 + After market 직납 구조" → 공급망 효율화·원가 경쟁력 확보**

1) Before market : 반도체 장비 도입 시 장비사로부터 번들 형태로 부품을 공급받는 초기 단계
2) After market : 장비 도입 이후 장비사 의존 없이 부품사를 통해 직접 조달·관리하는 단계

# 초정밀 반도체 공정 부품 트렌드를 리딩하는 Total Solution 파트너

CMTX
The World's Best Semiconductor Company

## 독보적인 기술력

600종 이상의 고객 맞춤형 제품 (Customized Products) 보유

세계 최초, 유일의 실리콘 무한재생기술 확보

## After Market 리딩기업

국내 최대규모 Si 소재 생산 역량 내재화

전(全) 공정 대응이 가능한 국내 유일 기업

## 레퍼런스로 입증되는 품질 경쟁력

국내 최초, 유일 TSMC 1차 협력사 선정

S사 1차 협력사 및 Q코드 최다 획득

20개 이상의 글로벌 FAB과 거래

INVESTOR RELATIONS 2025

Chapter 1.

# 회사 소개

01. 회사개요
02. 회사 연혁
03. 사업영역
04. 생산 인프라
05. Si Parts 제조 공정도
06. 경영성과(연결)

# 반도체 식각 공정 파츠 제조 전문 기업 "CMTX"

## 회사 개요

| | |
|---|---|
| 회사명 | ㈜CMTX |
| 대표이사 | 박성훈, 박종화 |
| 설립일 | 2013년 01월 18일 |
| 자본금 | 4,128백만 원 |
| 임직원 수 | 248명 |
| 주요사업 | 반도체 식각 공정용 실리콘 파츠 제조 |
| 사업장 | [본사, 공장]<br>제 1공장(C Campus)<br>경상북도 구미시 3공단3로 82-14<br><br>제 2공장(M Campus)<br>경상북도 구미시 5공단5로 118<br><br>[동탄 영업소]<br>경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, A동 3208호<br><br>[㈜셀릭]<br>천안시 서북구 4산단3로 15 |
| 홈페이지 | http://www.cmtx.co.kr/ |

자료 : 예심청구서 기준

## 주요 경영진

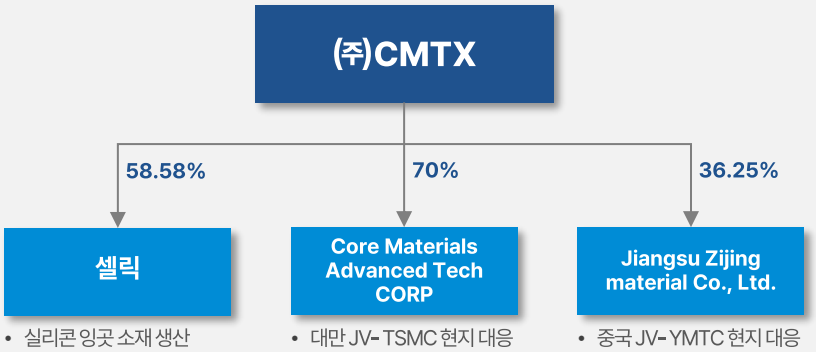
**대표이사 박성훈**

서울대학교 불어불문학과 졸업
㈜인터파크HM 본부장
(주)셀릭 대표이사
(2020.12.3 ~ 2022.12)
現 (주)씨엠티엑스 대표
(2013.2.1 ~ 현재)

**대표이사 박종화**

영남대학교 재료공학 박사
대구텍(주) 중앙연구소
(주)쌍용 중앙연구소
(주)원익큐엔씨 전무
(2010~2021)
現 (주)씨엠티엑스 대표
(2021.12.1 ~ 현재)

## 자회사 구조



02 Investor Relations 2025
회사 연혁

CMTX The World's Best Semiconductor Company

# 사파이어 파츠 기술력을 토대로 실리콘 파츠·소재로 사업 확장, 글로벌 시장 진출 가속화

## 2013~2016 설립기

### 세라믹/사파이어 부품 개발 및 기술 고도화

**2013** (주)코마테크놀로지 법인 설립
Sapphire 곡면 가공 기술 개발
Prous 세라믹 베큠척 개발
기술보증기금 벤처기업 인증

**2014** 공장 확장 이전 (경기 광주)
기업부설연구소 설립
ISO(국제품질경영) 인증 획득

**2015** CVD 장비용 Sapphire plasma injector 개발 및 양산
벤처기업 재인증
CVD SiC Ring 가공 공정 개발 / 표면처리기술개발
Eching(식각)공정용 Sapphire 2중 접합 노즐 개발

**2016** HDP-CVD 장비용 사파이어 사이드노즐 개발
FI 투자유치 - 기술보증기금
이노비즈(INNOBIZ) 기업 인증
SEMICON JAPAN 전시회 출품

## 2017~2020 성장기

### 실리콘 파츠 사업 진출 및 확대

**2017** HDP-CVD 장비용 사파이어 사이드노즐 양산(SK Hynix향)
부품소재전문기업 인증
특허 등록(엣지링 제조방법)
구미 신사옥 이전

**2018** Si 라인 확대, 클린룸 확장
SEMICON 한국,중국,대만,일본
인재육성형 중소기업 지정 수출유망중소기업 선정

**2019** FI 투자유치-머스트홀딩스
SEMICON 한국,중국,대만,일본
국방벤처협약(국방기술품질원)
ISO9001 / ISO14001(품질/환경경영시스템인증)
DB하이텍 성능평가인증
불산에칭(HF) 허가 취득

**2020** 불산에칭(HF) 허가 취득
주식회사 셀릭 설립
실리콘 라인 확장, 증설투자

## 2021~현재 도약기

### 실리콘 소재사업 진출, 국내외 Top-Tier 고객사 확보

**2021** 실리콘잉곳 소재사업 진출
OCI스페셜티 천안공장 인수
FI투자유치 – 머스트인베스트먼트, 케이투인베스트먼트
CaF2(불화칼슘)단결정 잉곳 원천기술개발 국책과제 주관기관선정
실리콘잉곳 소재 양산 시작
삼성전자 1차 협력사 등록
삼성전자 설비기술연구소 Si parts sole bander 등록
싱가포르 MICRON Si 파츠 양산
SI 투자유치 – 미코세라믹스
박종화 대표이사 취임

**2022** FI 투자유치 – 한국산업은행, 한국투자파트너스 투자유치
특허청장 표창(기술혁신)수상

**2023** 구미시 & 경북도 투자양해각서 체결(MOU) 및 신축공장 착공
경북 구미 최초 예비유니콘 기업선정
천만불 수출의 탑 수상
FI 투자유치 – 포지티브인베스트먼트,신한벤처투자/스퀘어브릿지,
티그리스인베스트먼트, 미래에셋벤처투자

**2024** 구미하이테크밸리 신축공장 공장등록 증설
신축공장 삼성전자 PCN Audit 완료
사명변경((주)코마테크놀로지 → (주)씨엠티엑스
「글로벌 강소기업 1,000+」기업 지정(중소벤처기업부장관)
삼천만불 수출의 탑 수상

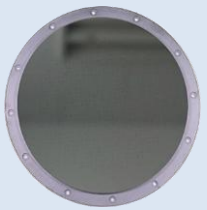
**2025** 도약(Jump-Up) 프로그램 선정(중소벤처기업부장관)
주식발행초과금의 자본금 전입
코스닥 상장예비심사청구

03 Investor Relations 2025
# 사업 영역

## 반도체 식각 공정의 핵심 소재, 실리콘 파츠에 역량 집중 및 강화

### 실리콘 파츠 (Silicon Parts)
식각 장비 내부, 반응 챔버의 내벽이나 구성 요소로 사용되는 소모성 부품

**실리콘 전극(Silicon Electrode)**
가스를 균일하게 흐르게 하고 플라즈마를 균일하게 생성시켜, 웨이퍼 미세선을 에칭하는 역할



**특수링( C-Ring, Outer-Ring)**
옥사이드 에칭 챔버 내에서 플라즈마를 와류시켜 웨이퍼에 집중시키는 역할

**하부 링(Focus Ring)**
웨이퍼 고정, ESC 제품 마모 방지, 플라즈마의 방향 및 밀도를 균일하게 조절하는 역할

CMTX
The World's Best Semiconductor Company

2024 매출액(연결)
1,087억 원

### 사파이어 파츠 (Sapphire Parts)
고온, 고강도, 고경도, 고내식성 요구 공정에서 사용

**사파이어 핀(Sapphire Pin)**
반도체 웨이퍼 핸들링 및 공정 중 지지 또는 정렬하는 역할

**사파이어 윈도우(Sapphire Window)**
반도체 공정 장비의 고온/고진공 상태에서 내부를 관찰하는 용도

### 기타
쿼츠 파츠, 자회사 실리콘 잉곳 소재 매출 등

### 세라믹 파츠 (Ceramic Parts)
식각(Etch), 증착(CVD), ALD, CMP 공정에서 금속 오염·부식 방지 목적 사용

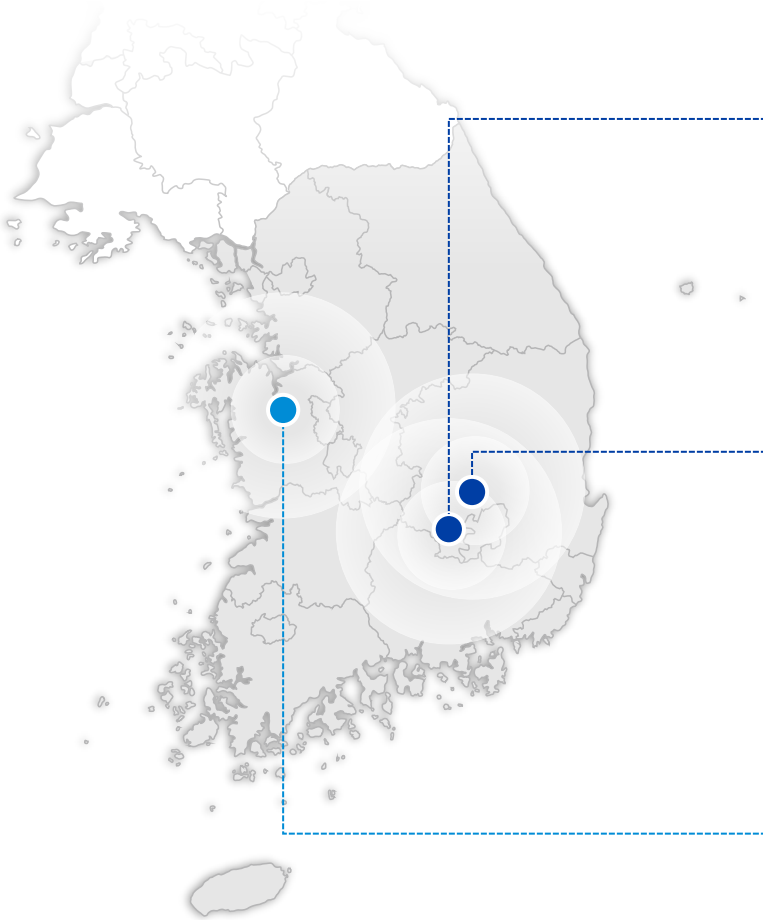
**세라믹 노즐(Ceramic Nozzle)**
반응 가스를 웨이퍼 위에 분사 시, 플라즈마의 분포를 균일하게 유지하고, 화학적 부식 및 파티클 발생 최소화

**세라믹 링(Ceramic Ring)**
웨이퍼 Edge 근처 막질과 플라즈마의 균일성 유지, 절연체 역할, 금속 파트 보호 및 파티클 오염 방지

04 Investor Relations 2025

# 생산 인프라

## 잉곳 소재 생산부터 최종 파츠 생산까지 수직 계열화 된 생산 설비를 기반으로 국내외 수요 대응



### 구미 공장 식각 공정용 Si 파츠 생산

#### 1공장(C Campus) 국내 수요 대응

위치 : 경상북도 구미시 3공단 3로 82-14

| 시설현황 | 주요 생산제품 |
|---|---|
| **총 면적**<br>토지 9,556m² (약 2,896평)<br>건물 9,373m² (약 2,840평) | **에칭 공정용 최종 Si Parts 생산**<br>: Silicon Parts<br>-Si Ring, Si Electrode |

#### 2공장(M Campus) 해외 수요 대응 [공모자금 활용 계획]

위치 : 경상북도 구미시 5공단5로 118

| 시설현황 |
|---|
| **총 면적**<br>토지 51,596m²(약 15,000평) / 2022년 3월 계약<br>건물(A동) 16,500m²(약 5,000평) / 2023년 12월 준공<br>건물(B동) 15,000m²(약4,500평) / 2025년 12월 착공 예정 |

### 자회사 (주)셀릭 반도체용 실리콘 잉곳 소재 생산

위치 : 충청남도 천안시 서북구 4산단로 15

| 시설현황 | 주요 생산제품 |
|---|---|
| **총 면적**<br>토지 12,272m² (약 3,720평)<br>건물 9,403m² (약 2,849평) | **Si 파츠용 실리콘 잉곳 소재 생산**<br>: 단결정/다결정 Crystal Si Ingot |

자료: 당사 자료

05 Investor Relations 2025

# Si Parts 제조 공정도

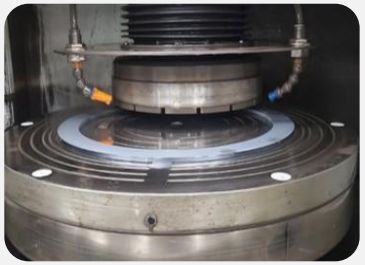
## Si Parts의 전 공정 수직 계열화와 글로벌 최고 수준의 클린룸 운영을 통해 Particle 컨트롤 역량 확보

### 전(前)공정

**Preparation Si Material**

Cropping ~ Slicing

**Surface Grinding**



Flatness / Parallelism Machining

**Shape Machining / Drilling**

Taper(Angle) / Tap / Hole Machining

**Measuring**

### 후(後)공정

**Etching**

Remove damage layer

**Polishing / Lapping**

**Final Cleaning**

Particle cleaning

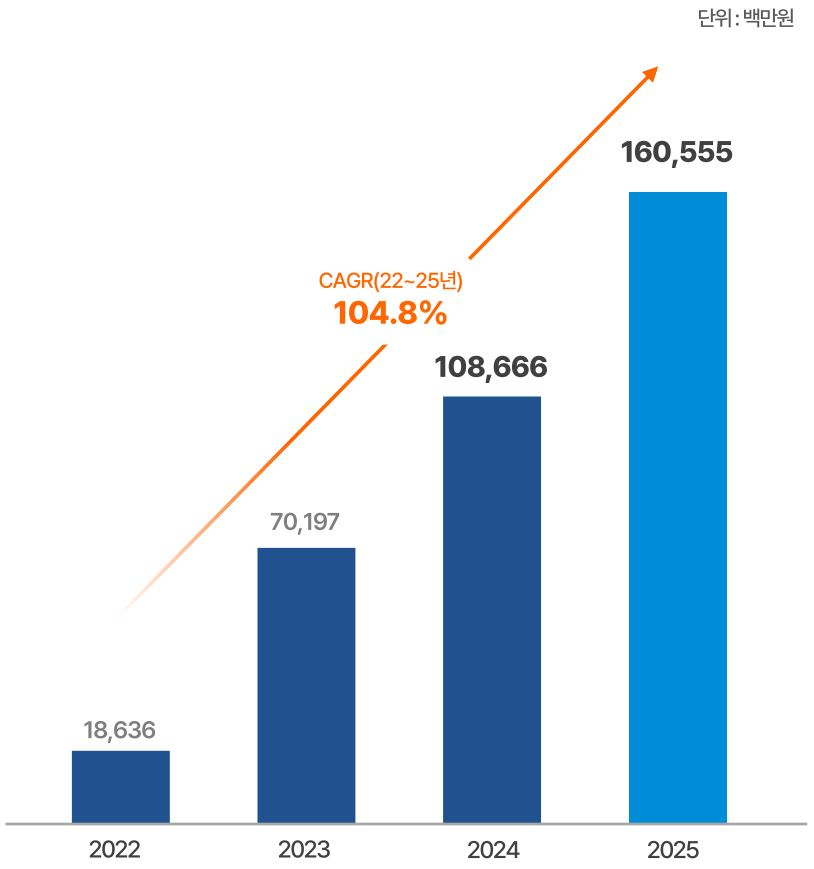
**Final Inspection/ Packaging**

Visual inspection

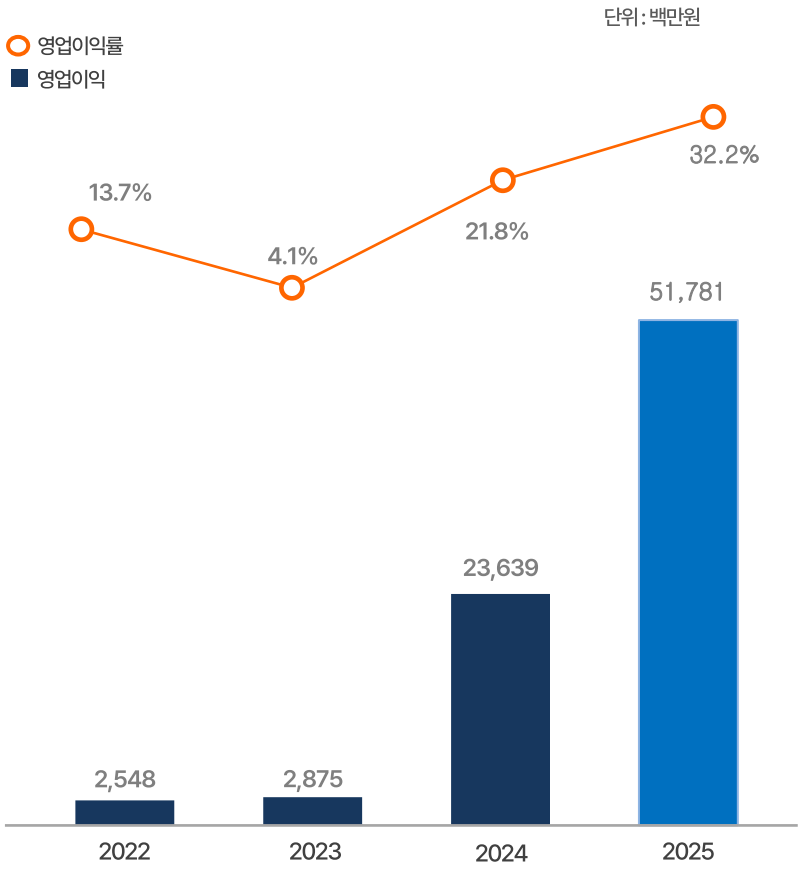
1) Class : 1 제곱미터당 Particle 개수 단위

# 최근 4개년 매출 연평균 104.8% 성장, 외형 확대와 함께 이익도 동반 급증

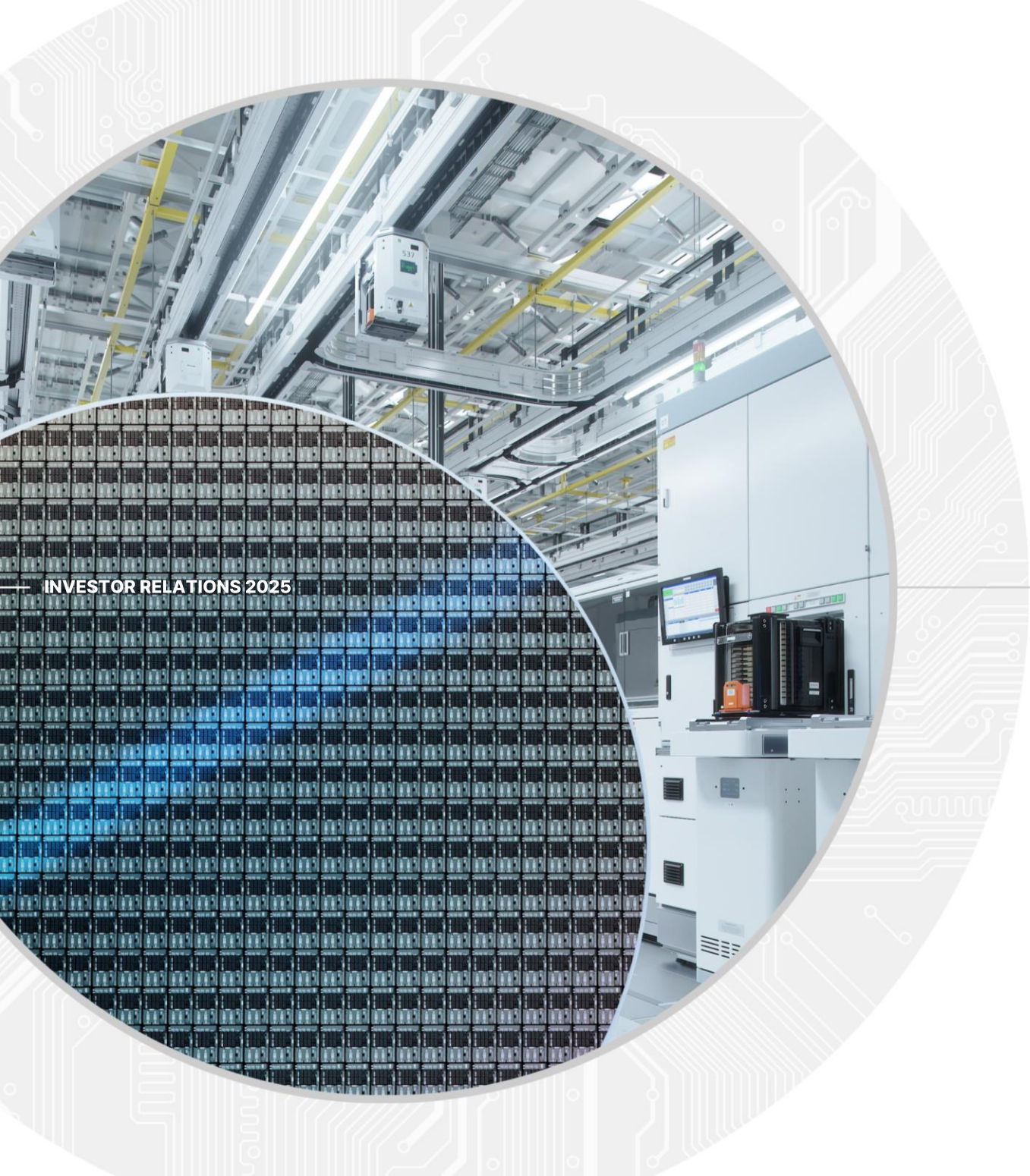
## 매출액




## 영업이익 및 영업이익률




자료 : CMTX DART 공시



INVESTOR RELATIONS 2025

Chapter 2.

# Core Competitiveness


01. 소재 내재화 역량

02. CMTX의 차별화 역량

03. 반도체 Parts 기술 선도 (1) S사

03. 반도체 Parts 기술 선도 (2) TSMC

04. 진입장벽 구축

05. 글로벌 고객 레퍼런스

06. 수익성 지표 비교

# 내재화된 소재 생산 역량으로 구축된 전 공정 수직계열화

## Si 소재 생산 역량 확보

- 2020.12 (주)셀릭 설립
- 2021.01 OCI 스페셜티 천안공장 인수
- 2021. 02~07 그로워 장비 개조
- 2021. 08~12 시험가동, 생산 안정화, 수율 강화
- 2022. 01~12 본격 양산(연간 70톤 단결정 실리콘 잉곳 생산) (주)셀릭 투자유치
- 2024. 01~12 연간 200톤 단결정/다결정 실리콘 잉곳 생산

[Si Parts용 단결정 잉곳]

**[소재 생산 기술 내재화]**

원가 경쟁력 + 공급 대응력 + 균일한 품질 보증

**국내 외 다수의 FAB 소재 공급 진행**

## 소재-부품 전 공정 수직계열화 구축

**[소재 및 부품 생산을 아우르는 전 공정 수직 계열화]**

1 소재 생산 → 2 부품 생산 → 3 부품 세정 → 4 품질 관리

**기대효과 1.** 고객사 요구에 대한 대응 속도와 품질 일관성 강화로 경쟁사 대비 전략적 우위 확보

**기대효과 2.** 생산 효율과 원가 구조 안정화를 통한 수익성 제고 및 가격 경쟁력 강화

# 전 공정 대응력과 독자 기술로 구축한 CMTX 경쟁 우위

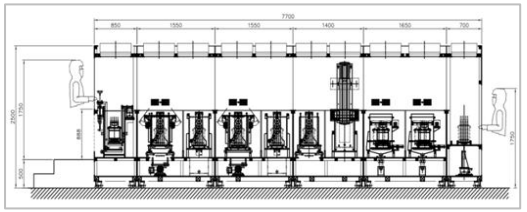
## 국내 최고 수준의 기술력 보유

### 1. 초정밀 가공기술

| 제품군 | | 보유 기술의 경쟁력 |
|---|---|---|
| 실리콘 파츠 | 블랙곡면전극, 곡면전극 / 일반전극 C-Ring / 일반링 | - Hole 가공기술 (미세홀 가공)<br>- 곡면형상 가공 기술<br>- Hole 에칭 및 세정기술 (감압방식 및 자동화세정)<br>- Slot 형조방전 기술<br>- Black (Texturing) surface 구현 (Ra control) |
| 세라믹 파츠 | 웨이퍼 현상액 첨가제 반도체 공정소재 | - 고순도 정제기술<br>- 이온교환수지 정제기술<br>- 극미량 분석기술 |

### 2. 에칭 세정 자동화 기술

**농도, 온도 미세 컨트롤 기술이 핵심**
→ 세정 품질 향상, 공정 오염 재발 방지, 수율 개선 효과 : 고객사 TEST 진행 중



**고순도 고수율의 차세대 Si Parts 제조 기술의 필수 핵심 요소**

## CMTX의 차별화된 경쟁력

국내 유일 After Market 전 공정별 엔지니어 확보
→ 고객 맞춤 솔루션 제공

**차별화된 공정 대응력으로 장기적 파트너십 확보**

03 Investor Relations 2025

# 반도체 Parts 기술 선도 (1) S사

## 장비사를 넘어선 맞춤형 대응, 전략적 파트너십 실현

CMTX
The World's Best Semiconductor Company

독보적인 기술력 + 소재-부품 수직 계열화 + 품질 인증

**CMTX 사업 역량**

- 소재 - 부품 전 공정 수직계열화로 빠른 대응과 원가 절감 효과 실현
- 독보적인 기술력으로 OEM 제품 대비 고품질 제품 공급
- 고객 맞춤형 제품과 대량 양산 CAPA 확보로 즉각적인 대응 가능
- 다수의 FAB과 직접 거래를 통해 쌓아온 글로벌 레퍼런스로 신뢰성 확보

공정 효율 DATA 요구 ←

→ DATA 제공 및 요구 스펙 대응

**S 사**

- 장비사 외 파츠 업체와의 경쟁을 통해 단가 인하 유도
- FAB 공정 조건에 맞춘 고성능 커스터마이징 파츠 요구
- 리드타임 단축 및 공급 안정성 확보 요구
- 점진적인 Parts 국산화 니즈 증가

대응 한계 ↑

공정 효율 DATA요구 ↓

**장비사**

- 자사 엔지니어 중심으로 FAB 내부 장비 직접 운용
- 독점적 권한을 통해 고객의 기술적 자율성 제한
- 파츠 단위의 공정 DATA 제공 불가능

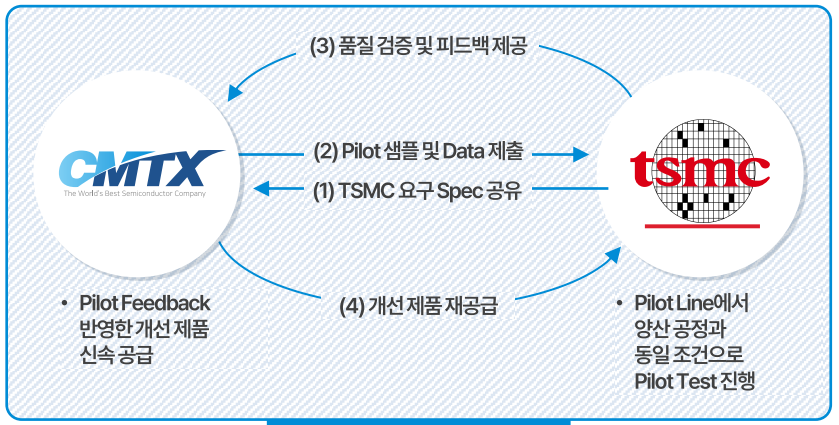
| 전략적 파트너십 현황 | 1차 협력사 등록 | 현 최대규모 국산화 협력사 | 내부 품질인증 Q 코드 최다 획득 |
|---|---|---|---|

03 Investor Relations 2025

# 반도체 Parts 기술 선도 (2) TSMC

## TSMC가 선택한 국내 유일 1차 협력사, 글로벌 기술 신뢰 확보

### TSMC 1차 협력사 등록




2년 이상의 반복적인 제품 Test 진행

| | |
|---|---|
| TSMC 테스트 통과 | 메모리 → 비메모리 사업 확장 |
| 국내 최초, 유일 1차 협력사 등록 | 기술·품질 경쟁력 인정 |
| 선단공정 양산라인 진입 기반 마련 | 성장성 + 안정성 동시 확보 |

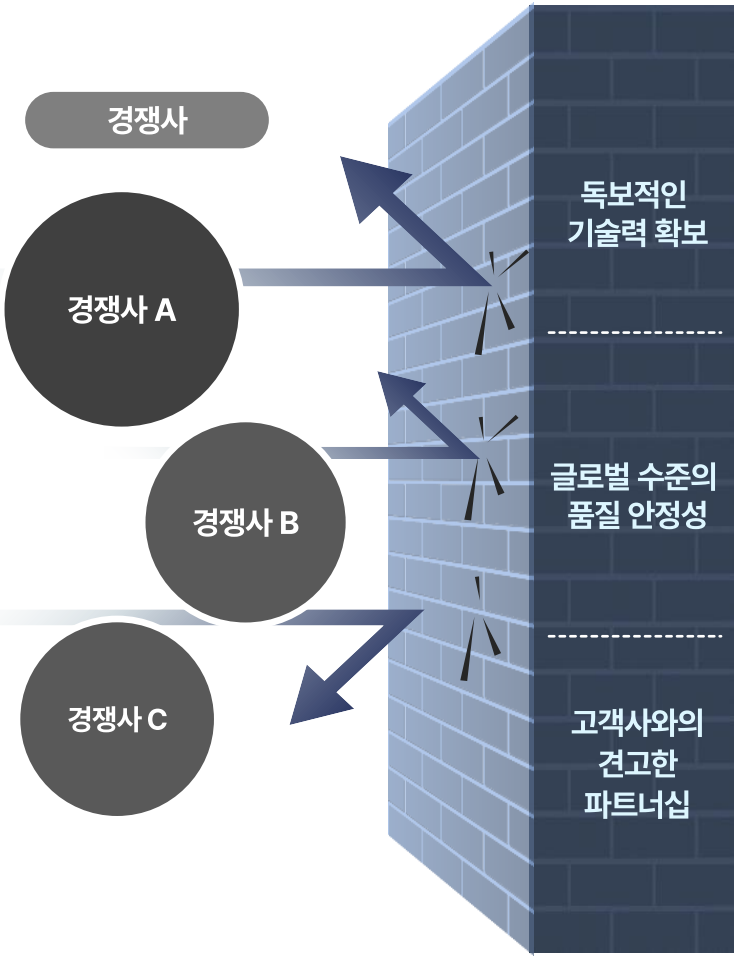
### TSMC 선단공정 진입 현황

- TSMC 선단공정 공급망 정식 편입 확정 (2025년 2월)
- 3nm, 2nm 선단공정의 양산공정 적용 확정 (FAB 18, FAB 20)
- 1.6nm / 1.4nm 초선단공정 우선적 기술협력사 선정

04 Investor Relations 2025

# 진입장벽 구축

## 차별화된 기술력과 품질 안정성, 견고한 파트너십을 통해 지속 가능한 중장기 성장 기반 확보



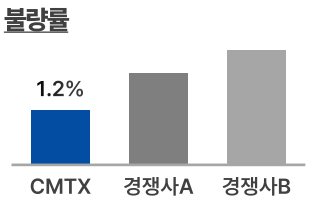

### 선단공정을 이끄는 차별화된 기술 경쟁력 확보

- 초정밀 가공기술 기반 3nm 이하 선단공정에서 고객 요구에 최적화된 대응 역량 확보
  → 불량률 및 공정 편차 최소화로 수율 극대화
- 에칭 세정 자동화 기술을 통해 공정 오염 방지 및 파티클 Issue 대응 역량 강화
  → 미세화 공정에 필수적인 차세대 Si Parts 개발의 핵심 요소

수율 극대화 및 차세대 Parts 개발 역량 확보

### 품질 경쟁력으로 신뢰 구축

- 600종 이상의 제품 불량률 1.2%로 경쟁사 대비 우월
- 해외 FAB 수출 제품 파티클 및 부적합 Issue "ZERO"



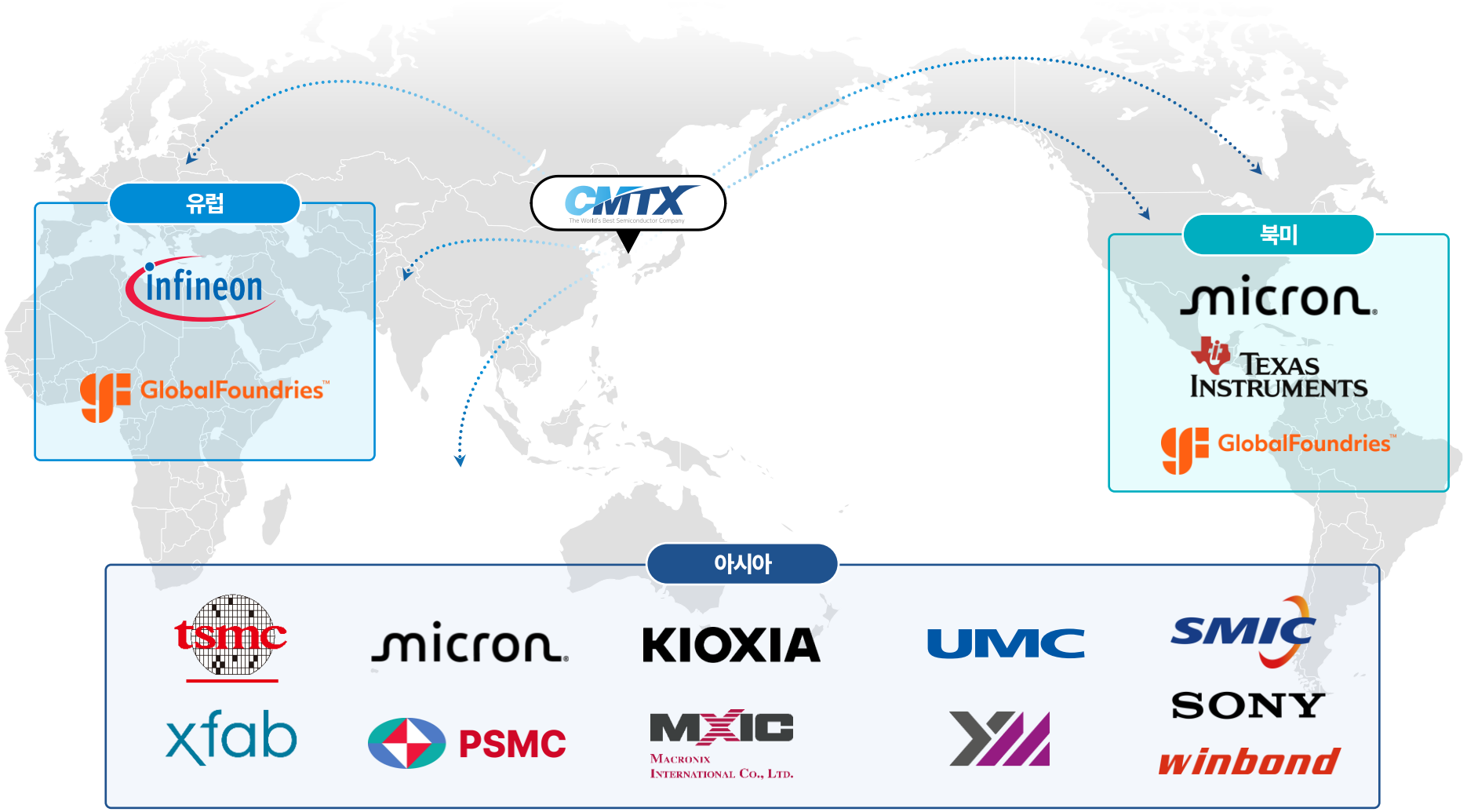

### 소재 전환 락인효과

채택 이후 타사 진입의 어려움

파트너십 활용한 차세대 공정 선점 용이

고객사 S사

# 글로벌 20개 이상의 FAB과 거래 진행

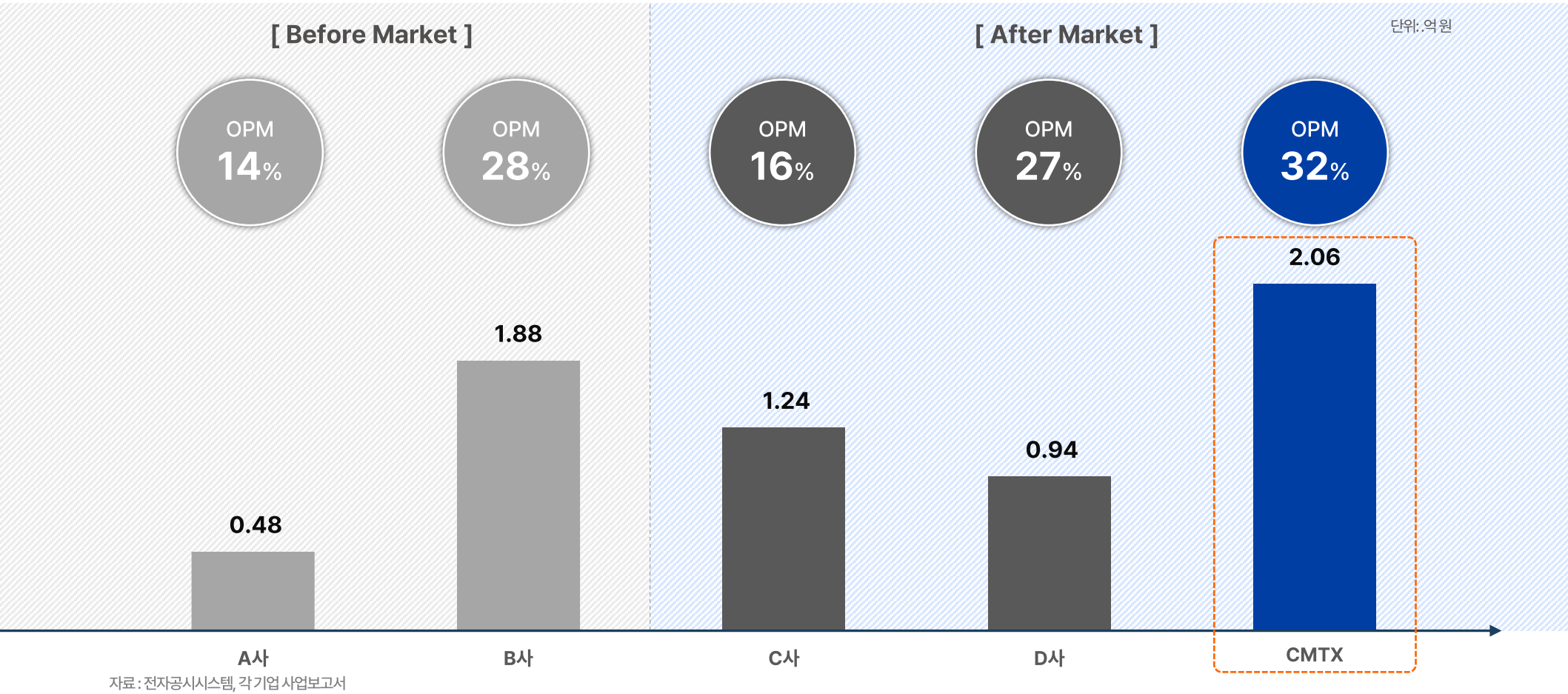


06 Investor Relations 2025

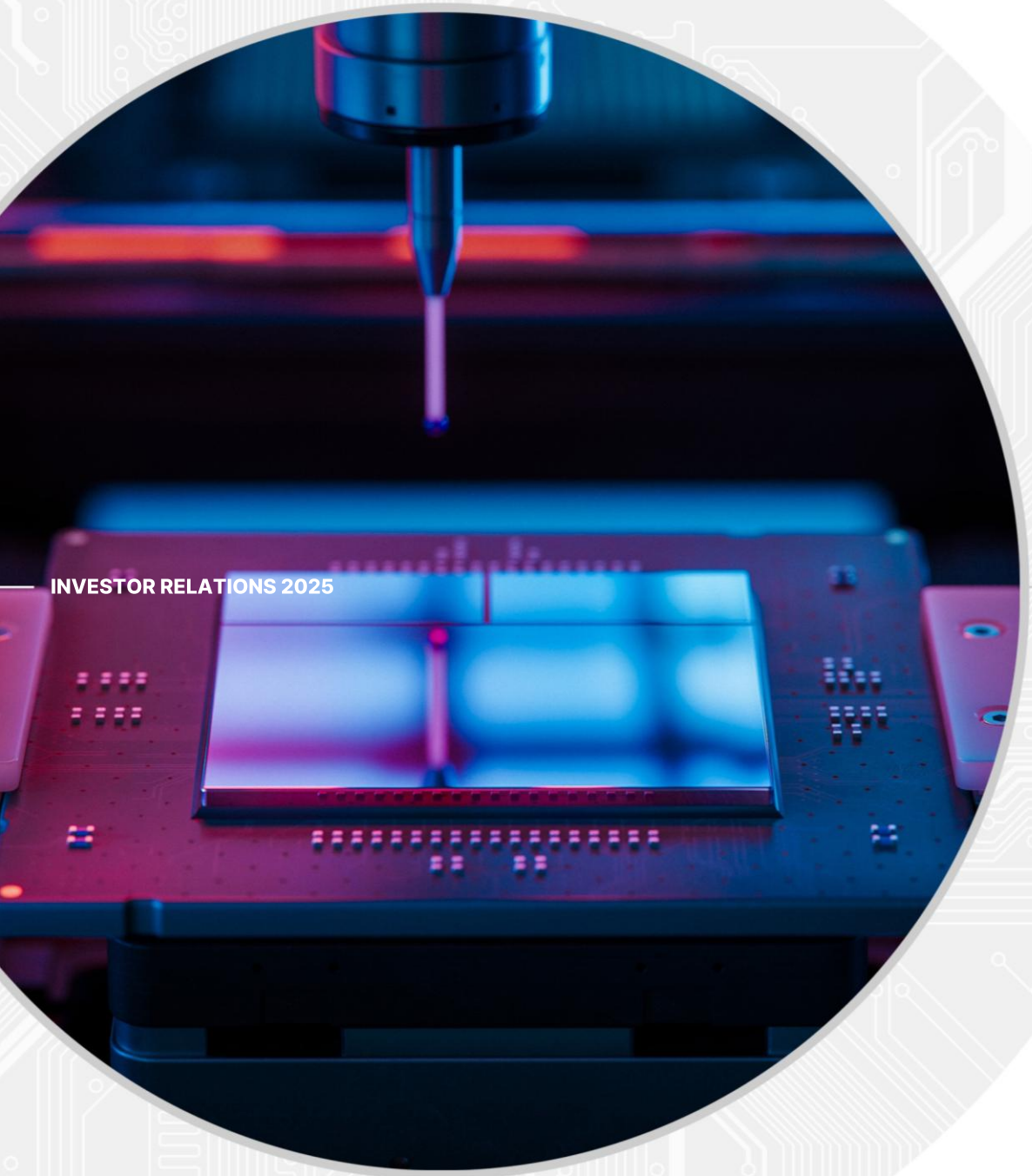
# 수익성 지표 비교

## 업계 최고 수준의 독보적인 수익성 확보, 1인당 영업이익 2.06억 및 영업이익률 32% 달성

**Market 별 1인당 영업이익 및 영업이익률** (25.1H 실적 기준, 단순 연환산 지표)




자료 : 전자공시시스템, 각 기업 사업보고서



INVESTOR RELATIONS 2025

Chapter 3.

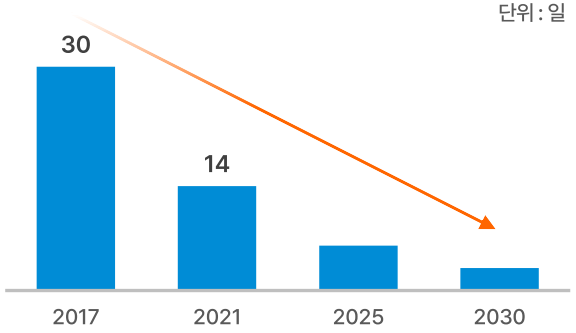
# Growth Strategy


01. 글로벌 Si 파츠 시장규모 및 전망
02. 반도체 제조사 최근 동향 (1) 원가 절감
02. 반도체 제조사 최근 동향 (2) 기술적 자립
03. 주력 제품 매출 확대
04. 소재 Recycling 사업
05. 신기술 개발
06. 매출 Forecast
07. 투자 하이라이트

# 식각 공정용 Si Parts 시장 확대와 함께 CMTX의 동반 성장 기대

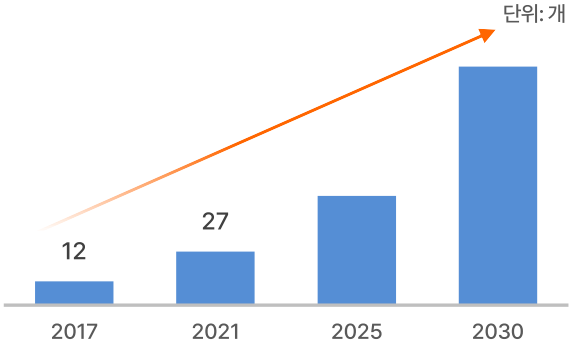
## Focus Ring 교체주기

식각 공정 미세화·고단화 추세로 파츠 교체 주기 감소




## Foucus Ring 연간 필요량

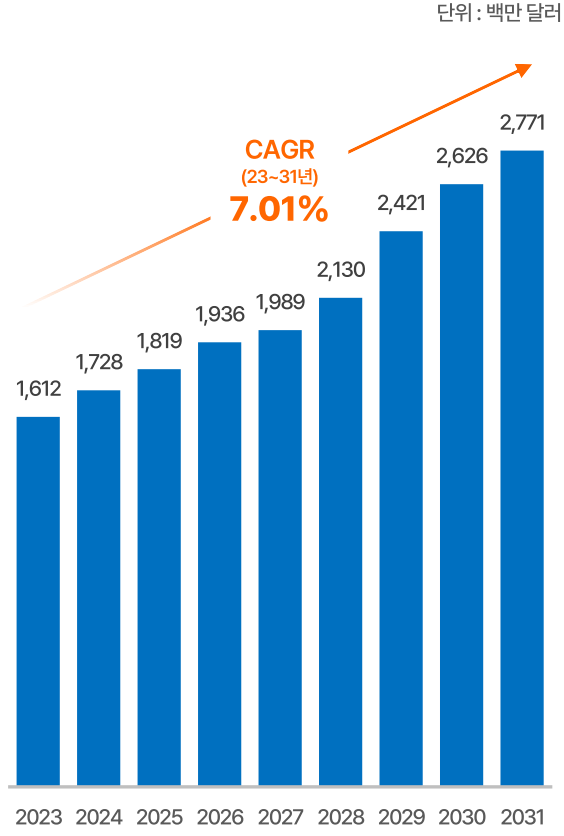
식각 공정 미세화·고단화 추세로 파츠 사용량 증가




자료 : 하나증권 리서치센터

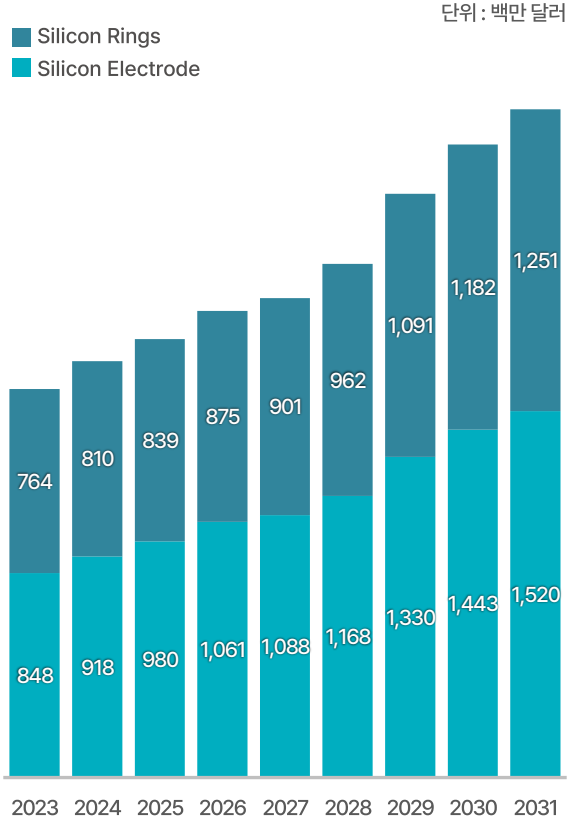
## 글로벌 식각용 실리콘 파츠 시장규모

식각 공정의 미세화·고단화 추세로 실리콘 소재 채택 확대




## 제품 유형별 실리콘 파츠 시장규모

글로벌 FAB의 Silicon Ring, Electrode 사용 증가 영향



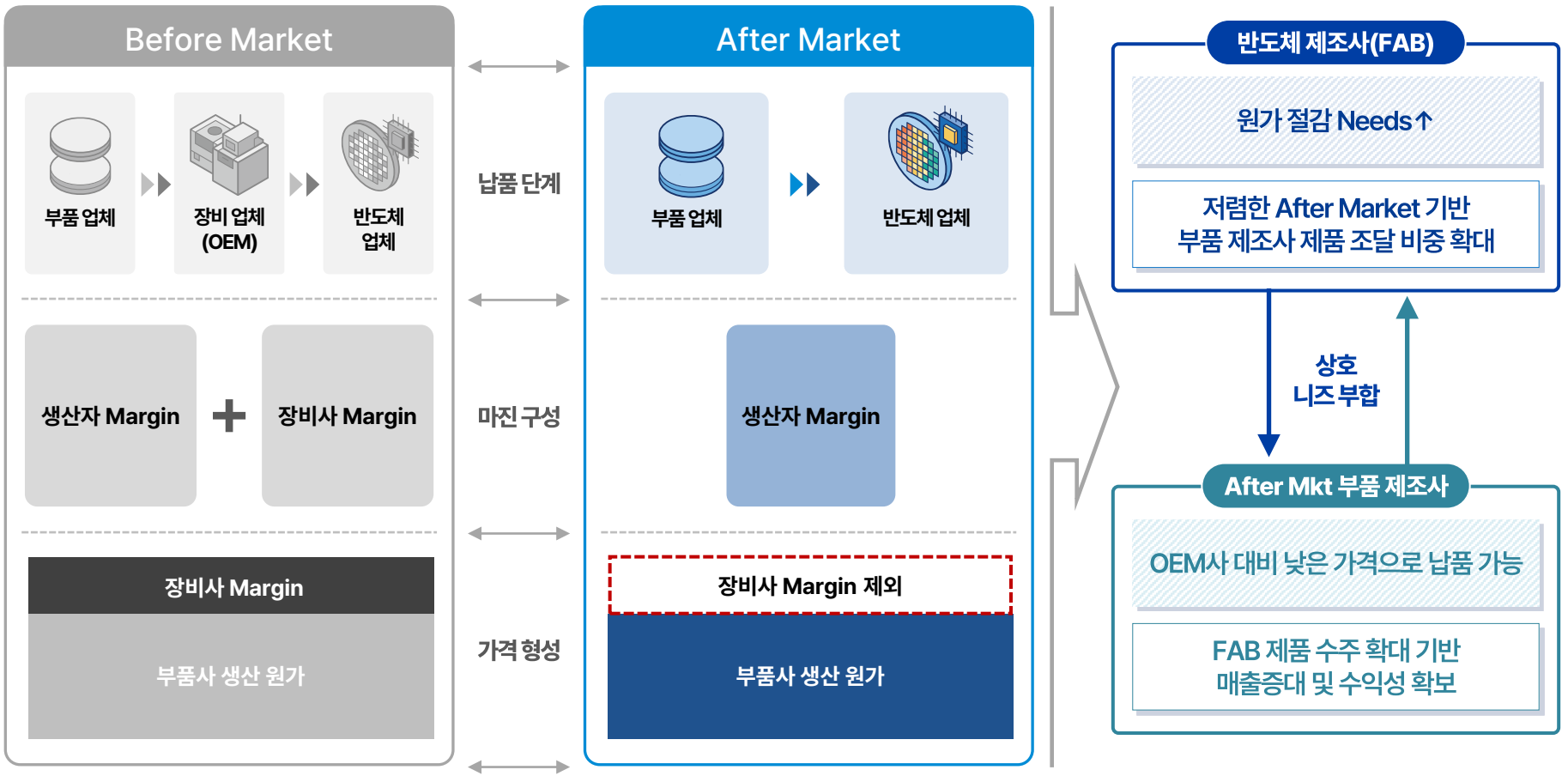

자료 : QYresearch - Global Silicon Parts for Etching Market Research Report 2025

02 Investor Relations 2025

# 반도체 제조사 최근 동향(1) 원가절감

## 장비업체를 거치지 않고 직납하여 원가를 절감할 수 있는 After Market 기반의 제품 조달 구조 부각

**Before Market VS After Market**



02 Investor Relations 2025

# 반도체 제조사 최근 동향(2) 기술적 자립

## FAB 기술 자립 수요 확대 → After Market 부품 제조사 선호 강화

### As-Is

외부 장비사 엔지니어 의존 고착화 + 내부 장비 조건 최적화 등 식각 공정 운영 권한 제한

**기존 거래 장비사에 대한 미충족 니즈 발생**

- 기존 장비사에 대한 의존 탈피
- 데이터·운영권 확보 필요성 증대
- 공정 안정성과 원가 절감 필요 증대

### To-Be

**FAB의 Needs**

FAB 자체 엔지니어 육성 → 외부 기술 의존도↓ + 수율·공정 데이터 확보↑

외부 기술 의존도↓ → 식각 공정 운영 권한 확보

수율·공정 데이터 확보↑ → Parts 단위 데이터 확보

**장비회사 vs 부품 제조사 비교**

| 글로벌 FAB, 요구사항 | 장비회사 (Before Mkt / OEM) | 부품 제조사 (After Mkt) |
|---|---|---|
| Parts 단위 데이터 제공 여부 | X | O |
| 공정 커스터마이징 유연성 제공 여부 | X | O |
| 자체 엔지니어링 역량 구축 가능 여부 | X | O |

부품 제조사에 공정 효율 데이터 요구 및 장기적 협력관계 구축

장비사 보증 유지용 최소 발주만 진행 → 핵심 수주는 부품사 중심으로 전환

**"부품 제조사 협력을 통한 FAB 기술 자립 가속화"**

03 Investor Relations 2025

# 주력 제품 매출 확대

## S사 향 납품 확대 및 기업별 맞춤 전략을 기반으로 주력 제품 매출 성장 가속화

### S사 매출 확대 전략

2021년 1차 협력사 등록 이후
**현 최대규모 국산화 협력사**

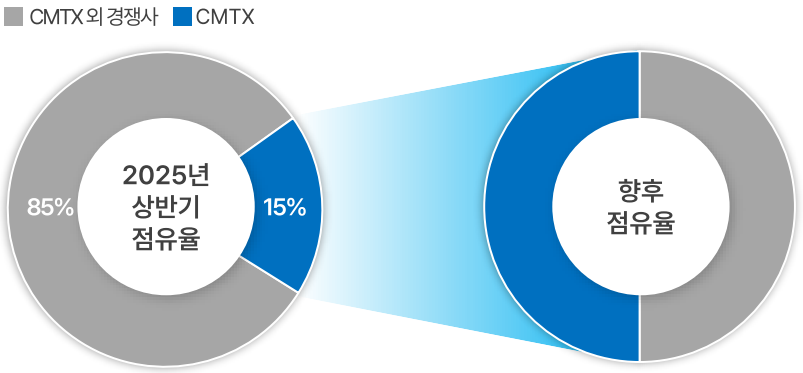
NAND 국산화에 이어
**DRAM 의 본격적 국산화 핵심 협력사**

### 해외 FAB 매출 확대 전략

**FAB별 맞춤형 전략 실행을 통해 주력 제품 매출 확대 및 매출처 다변화**

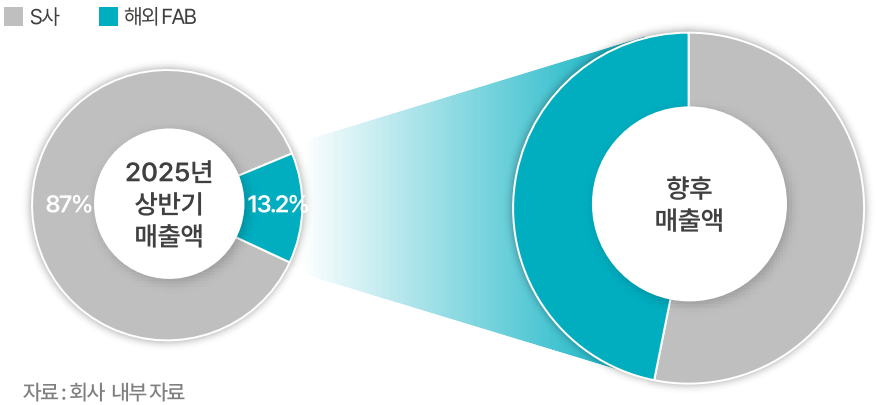
| | |
|---|---|
| tsmc | • 1차 벤더 등록 완료<br>• 3nm 이하 선단공정에 당사 제품 사용 확정 (After Market 제품 첫 채택 ) |
| micron | • 고부가가치 제품에 본격적 After Market 제품 사용 시작<br>• Qual 테스트 통과 및 1차 벤더 등록 완료 |
| KIOXIA | • Qual 테스트 통과 및 직접 벤더 등록 완료<br>• 고부가가치 제품 위주의 본격적인 기술영업 진행 |

### Si Parts 납품 경쟁사 대체율 확대




자료 : 회사 내부 자료

### 해외 FAB 점유율 확대




자료 : 회사 내부 자료

# 세계 최초 "Si 폐파츠 무한 재생 기술" 개발, 반도체 소재 게임체인저로 도약

## 무한 재생 리사이클 시스템 구축

### Material Purity Improvement Method

- 공정별 이물질 제거 방식 및 장입 방식의 개선
- 폐Wafer 활용 기술을 통해 폐파츠의 순도를 기존 Poly 단계보다 높이는 동사만의 핵심 기술

**일반 파츠 대비 재활용 파츠의 순도·기대수율 동일, 가격은 저렴**

## 지속가능 성장 전략

**확장성 기반, Top-Tier FAB 협업 확대**

| | |
|---|---|
| micron | • 리사이클(Recycle) 부품 QUAL TEST 통과 |
| S사 | • 공동 공정 평가 진행 확정 |

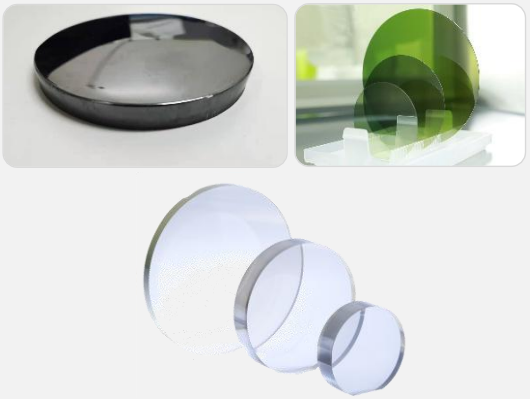
**ESG 규제 대응을 통한 신사업 진출**

- 글로벌 ESG 선도 고객사와의 장기 거래 및 프리미엄 계약 기회
  → Poly Silicon 소재 공급망 대응을 통해 매출 확보·수익성 제고
- Recycle Si 활용 시 대규모 에너지 절감 및 탄소 저감 효과 ↑
  → 탄소배출권(연간 약 1.35억 원) 거래 가치 창출 가능
- 리튬 등 2차전지 핵심소재 폐소재 사용 의무화 시행 확대 ↑
  → 반도체 산업에서도 폐소재 활용 규제 도입 가능성 부각

**품질 인증을 통한 리사이클링 소재 공급 확산,
공급망 안정·ESG 가치 창출**

# 차별화 된 기술 역량을 바탕으로 신소재 · 특수 소재 개발 및 소재시장 선도

## 단결정 SiC



## 특수 Silicon 소재

CVD SiC 대체

## 대구경 Silicon 소재

대구경 Parts 대체

| 분 류 | 세부 제품명 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| 단결정 SiC | Power Device 용 SiC Wafer | 설비 도입, 성장 공정 개발 | 대구경(12")개발 | Wafer 제작공정 구축 |
| | Smart Glass용 Semi-insulated SiC | 설비 도입, 성장 공정 개발 | 고순도 성장 공정 확보 | 특성별 가공 기술 확보 |
| 특수 Silicon | 내식각성 Parts (Focus Ring / Electrode) | 잉곳 성장기술 개발 | 내식각 평가, 최적화 | 제품화 |
| 대구경 Silicon | Chamber Wall (Dry etcher) | Grower 개조 | 잉곳 성장기술 개발 | 제품화 |

자료 : 회사 내부 자료